

3-5535677-9 ✓ 有效

AMPMODU | AMPMODU IV/V

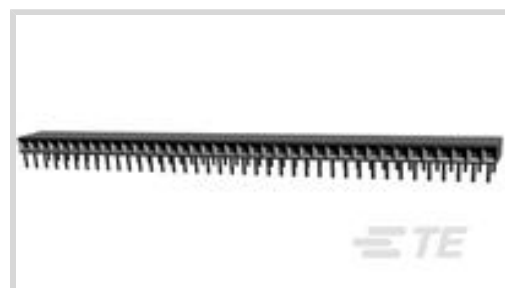
TE 内部编号 3-5535677-9

PCB Mount Receptacle, Right Angle / Horizontal, Board-to-Board,  
39 Position, 2.54 mm [.1 in] Centerline, Tin, Through Hole - Solder,  
AMPMODU IV/V

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



连接器系统: 板对板

位数: 39

行数: 1

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

PCB 安装方向: 水平, 直角

## 产品特性

### 产品类型特性

|             |          |
|-------------|----------|
| 施加的压力       | 标准, 高    |
| 连接器系统       | 板对板      |
| 可密封         | 否        |
| 连接器和端子端接到   | 印刷电路板    |
| PCB 连接器组件类型 | PCB 安装母端 |

### 结构特性

|          |        |
|----------|--------|
| 板对板配置    | 垂直     |
| 可堆叠      | 是      |
| 位数       | 39     |
| 行数       | 1      |
| PCB 安装方向 | 水平, 直角 |

### 电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 绝缘电阻 | 5000 MΩ |
| 工作电压 | 333 VAC |

### 主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 连接器外形  | 标准 |
| 主要产品颜色 | 黑色 |

### 接触件特性

|                  |  |
|------------------|--|
| 端子保护类型           | 闭合入口壳体                                 |
| 接合方柱尺寸           | .64 mm[.025 in]                        |
| PCB 端子端接区域电镀材料厚度 | 3.81 – 7.62 $\mu$ m                    |
| 端子布局             | 直插式                                    |
| 端子接合区域电镀材料厚度     | 3.8 – 7.62 $\mu$ m[150 – 300 $\mu$ in] |
| 端子形状和构造          | 短点                                     |
| 端子接触部电镀材料表面涂层    | 哑光                                     |
| PCB 端子端接区域电镀材料   | 锡                                      |
| 端子基材             | 磷青铜                                    |
| 端子接触部电镀材料        | 锡                                      |
| 端子类型             | 插座                                     |
| 端子额定电流（最大值）      | 2 A                                    |

#### 端接特性

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 矩形端接柱体和尾部厚度 | .2 mm[.008 in]   |
| 矩形端接柱体和尾部宽度 | .69 mm[.027 in]  |
| 端接柱体和尾部长度的  | 2.92 mm[.115 in] |
| PCB 端接方法    | 通孔 - 焊接          |

#### 机械附件

|          |     |
|----------|-----|
| 连接器安装类型  | 板安装 |
| 接合对准     | 不带  |
| PCB 安装对准 | 不带  |
| PCB 安装固定 | 不带  |

#### 壳体特性

|         |                |
|---------|----------------|
| 接合入口位置  | 侧              |
| 外壳材料    | 聚酯 - GF        |
| 中心线（间距） | 2.54 mm[.1 in] |

#### 尺寸

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| 连接器高度      | 3.48 mm[.137 in]             |
| PCB 厚度（建议） | 1.4 – 2.4 mm[.055 – .094 in] |
| 行间距        | 7.87 mm[.31 in]              |

#### 使用环境

|         |   |
|---------|---|
| 壳体温度额定值 | 高 |
|---------|---|



工作温度范围 -65 – 125 °C[-85 – 257 °F]

### 操作/应用

|        |        |
|--------|--------|
| 焊接工艺特性 | 板支座    |
| 电路应用   | Signal |

### 行业标准

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| 与已批准的标准产品兼容 | CSA LR7189, UL E28476 |
| UL 阻燃性等级    | UL 94V-0              |

### 包装特性

|      |           |
|------|-----------|
| 封装方法 | Box, Tube |
|------|-----------|

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|   |   |
|---|---|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料   |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量  | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。  |
| 焊接工艺能力  | 回流焊接可达到 260°C   |

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

### 配套部件



## 该系列中的其他产品 | AMPMODU IV/V



## 客户还购买了





## 文档

### 产品图纸

[39 MODII HORZ SR CE 100CL](#)

英文版本

### CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_3-5535677-9\\_A.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_3-5535677-9\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_3-5535677-9\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

### 数据表/目录页

[AMPMODU\\_INTERCONNECTION\\_SYSTEM\\_SECTION5](#)

英文版本